

551,048

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
7. Oktober 2004 (07.10.2004)

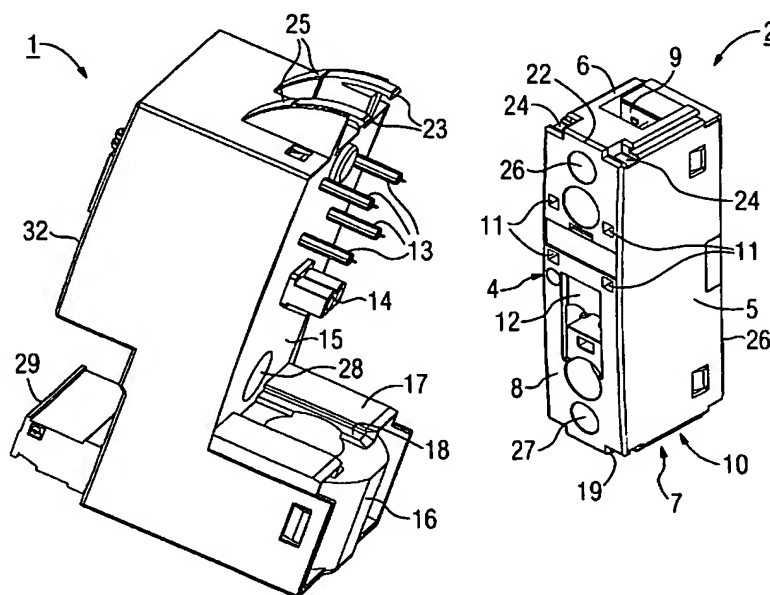
PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/086834 A1(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **H05K 7/02**(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2004/001175**(22) Internationales Anmeldedatum:
9. Februar 2004 (09.02.2004)(25) Einreichungssprache: **Deutsch**(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**(30) Angaben zur Priorität:
03007172.4 28. März 2003 (28.03.2003) **EP**(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE];**
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **APFELBACHER,**
Walter [DE/DE]; Wiesenstr. 35, 92271 Freihung
(DE). **LEHMEIER, Annemarie [DE/DE];** Winkl 6,92289 Ursensollen (DE). **SEITZ, Johann [DE/DE];** Im
Drillingsfeld 14, 92224 Amberg (DE).(74) Gemeinsamer Vertreter: **SIEMENS AKTIENGE-**
SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, 80506 München
(DE).(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): **ARIPO (BW,**

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: **SEMICONDUCTOR RELAY**(54) Bezeichnung: **HALBLEITERRELAIS**

(57) Abstract: A semiconductor relay (2) comprises an essentially parallelepiped-shaped housing (20) that has a fastening side (3) and four lateral surfaces (4, 5, 6, 7), which are perpendicular thereto, and has a front side (8), which is opposite the fastening side (3). These lateral surfaces and front side serve as connecting sides (4, 5, 6, 7, 8). At least one electrical connecting element (11, 12) and at least one mechanical connecting element (19, 24) for connecting a functional module (1), which can be connected to the housing (20), are provided on a number of connecting sides (4, 5, 6, 7, 8).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2004/086834 A1



GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Ein Halbleiterrelais (2) weist ein im Wesentlichen quaderförmiges Gehäuse (20) auf, welches eine Befestigungsseite (3) sowie vier senkrecht zu dieser angeordnete Seitenflächen (4, 5, 6, 7) und eine der Befestigungsseite (3) gegenüberliegende Frontseite (8) als Anschlussseiten (4, 5, 6, 7, 8) hat, wobei an einer Anzahl Anschlussseiten (4, 5, 6, 7, 8) insgesamt mindestens ein elektrisches Verbindungselement (11, 12) und mindestens ein mechanisches Verbindungselement (19, 24) zum Anschluss eines mit dem Gehäuse (20) verbindbaren Funktionsmoduls (1) vorgesehen sind.